# 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号 2021-008

投资者来访类别	■特定对象调研	□分析师会议
	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□现场参观
	□一对一沟通	
	□其他	
来访单位 名称及人 员姓名	德邦电子 王俊之;中国人寿基金 张标、太平洋证券 沈钱;泰达宏利基金 崔梦图	张韬; 禅龙资产 陈鑫; 华西证券 熊军; 阳; 红线资本 梁文; 仙人掌资产 姚跃
时间	2021年5月13日	
地点	公司会议室	
上市公司 接待人员	潘一德、徐洁敏	
	首先由董事会秘书潘一德先生向分析	<b>沂师摘要介绍公司的情况、产品市场和公</b>
	首先由董事会秘书潘一德先生向分析 司未来发展的展望。然后现场回答了提问	
	司未来发展的展望。然后现场回答了提问 1、来宾问:公司如何解决产能?	
	司未来发展的展望。然后现场回答了提问 1、来宾问:公司如何解决产能? 公司主要代工在和舰、华虹等。公司	问,具体内容如下:
投资者来	司未来发展的展望。然后现场回答了提问 1、来宾问:公司如何解决产能? 公司主要代工在和舰、华虹等。公司	问,具体内容如下: 司主要产品为工业控制级别的微控制器芯
投资者来 访主要内 容介绍	司未来发展的展望。然后现场回答了提问 <b>1、来宾问:公司如何解决产能?</b> 公司主要代工在和舰、华虹等。公司 片,注重产品的安全性和环境承受的抗禁 圆代工。	问,具体内容如下: 司主要产品为工业控制级别的微控制器芯
访主要内	司未来发展的展望。然后现场回答了提问 <b>1、来宾问:公司如何解决产能?</b> 公司主要代工在和舰、华虹等。公司 片,注重产品的安全性和环境承受的抗死。 圆代工。 家电主控芯片采用 E-flash 制程,E	问,具体内容如下: 司主要产品为工业控制级别的微控制器芯 杂讯能力,一般多在成熟制程的8吋做晶
访主要内	司未来发展的展望。然后现场回答了提问 <b>1、来宾问:公司如何解决产能?</b> 公司主要代工在和舰、华虹等。公司 片,注重产品的安全性和环境承受的抗死。 圆代工。 家电主控芯片采用 E-flash 制程,E	司,具体内容如下: 司主要产品为工业控制级别的微控制器芯杂讯能力,一般多在成熟制程的8吋做晶 目前用的是8吋晶圆,新产品会投入12吋
访主要内	司未来发展的展望。然后现场回答了提问 1、来宾问:公司如何解决产能? 公司主要代工在和舰、华虹等。公司 片,注重产品的安全性和环境承受的抗衰 圆代工。 家电主控芯片采用 E-flash 制程,目 晶圆制程开发;锂电池管理芯片采用的是 望进一步打开。	司,具体内容如下: 司主要产品为工业控制级别的微控制器芯杂讯能力,一般多在成熟制程的8吋做晶 目前用的是8吋晶圆,新产品会投入12吋
访主要内	司未来发展的展望。然后现场回答了提问 1、来宾问:公司如何解决产能? 公司主要代工在和舰、华虹等。公司 片,注重产品的安全性和环境承受的抗衰 圆代工。 家电主控芯片采用 E-flash 制程,目 晶圆制程开发;锂电池管理芯片采用的是 望进一步打开。 显屏驱动芯片目前主要流片在国内的	司主要产品为工业控制级别的微控制器芯杂讯能力,一般多在成熟制程的8吋做晶目前用的是8吋晶圆,新产品会投入12吋是BCD制程工艺,如进入90纳米,产能可

公司自去年起已采取因应措施提前做好产能提升规划布局,积极应对晶圆厂、封装测试厂等上游供应链产能吃紧情况: 1)和晶圆供应商洽谈更长期的策略性紧密合作; 2)公司自购测试机台委托代工; 3)公司新产品尽量采用 12 吋晶圆制程,经济效益适足的老产品,也转入 12 吋晶圆制程。

由于公司上游产能还没完全纾解,晶圆增加的量还赶不上客户的需求。

# 2、来宾问:从贵司年报来看,公司营收增长,产品的颗数同比增加并不多?

潘一德:公司不同产品的价格差异大,因此营收增长与颗数增长,不会是 1:1 的关系。自去年下半年起,上游供应链的产能开始供应不足,公司目前库存成品 很少,大部分产品都是卖掉的,存货主要是半成品。

# 3、来宾问:公司家电的市场占有情况?

潘一德:公司工控类产品注重安全性和抗杂讯能力,客户的验证时间长,市场稳定性高,性价比高,产品的生命周期长,有的产品销售可以超过10年。国内小家电品牌客户大多都是公司的客户,主要都是上市公司,公司受益于客户产品的国产替代,大多数情况下,公司直接提供大客户工程服务。

# 4、来宾问:不同产品线的毛利率情况?

潘一德:家电产品线的毛利率较接近公司平均,AMOLED 显示驱动芯片,有单一产品量大,毛利率偏低的市场特性。公司短期争取的新增产能还是无法消化客户订单需求,但预期会逐季有些改善。新增产能部分的成本还是有所提高。长期来看,公司毛利率会随着产品组合而波动。利润率能够维持。

#### 5、来宾问: 锂电池管理芯片和 AMOLED 显示驱动芯片前、后装市场有何区别?

潘一德:一般前装市场对芯片和面板要求都很高,公司锂电池管理芯片产品已从后装市场逐渐进入了前装市场。

#### 6、来宾问:公司的研发规划?

潘一德:持续开拓家电市场,提高白色家电控制芯片市场份额,持续专注推广变频空调芯片;锂电池管理芯片,服务好一线品牌客户,做好品牌横向推广;及时推出迎合主流市场需求的 AMOLED 显示驱动芯片产品;持续投入研发,深耕电机应用市场;完善智能家居产品布局,加大 IIOT 投入;长期不间断的投入汽车电子控制芯片研发。

#### 7、来宾问: 锂电池管理芯片的情况?

潘一德:公司一季度锂电池管理芯片销售同比成长逾倍,锂电池管理芯片的增长贡献,主要是在品牌手机及 TWS 耳机的国产替代取得较好的进展,产品的各项性能得到了客户的认可,正在打开国产替代的道路上进一步开拓。

锂电池管理芯片的技术壁垒高,公司动力锂电池管理芯多用于电动自行车、 扫地机器人、电动工具等。

笔电的锂电池管理芯片在大品牌客户已有小量生产,今年将会做横向的市场 推广。

# 8、来宾问:公司芯片是否属于通用性?

潘一德:公司主要专注于细分市场,开发行业订制的 ASSP 产品,集成外围分立元器件,降低 BOM 成本;和国内新兴崛起的竞争者相比,公司产品在可靠性、品牌认可、供货能力等方面具有一定优势。公司在销售芯片的同时,还会为客户提供开发工具。

# 9、来宾问:公司是否考虑利用外延式增长来发展?

潘一德:对外投资进行收购也是公司经营的策略方向,公司一直有在评估。 主要关注重要的核心技术与公司技术的相关性及互补性,及收购公司研发团队将 来的稳定性,也要有协同效应及发展前景,通过策略伙伴的外延式发展,将公司 做强做大。2019 年末公司购买澜至的 wifi 团队已在研发新的产品,主要以低功 耗,高兼容,高可靠,传输距离长的 wifi 为主。这是公司在工控、家电、家居、 健康医疗等细分市场发力迈出坚实的一步,是公司 IIoT 战略布局的重要一环。

#### 10、 来宾问:公司 IOT 研发情况?

潘一德:公司已有的 MCU+蓝牙方案,已用于医疗领域,现在开发的 WiFi 技术主要以低工耗,高兼容,高可靠,传输距离长为主。公司现有的 32 位 MCU 主要用于变频空调领域及物联网应用。对于智能家居,公司 MCU 芯片会预留端口,让客户通过 wifi 或蓝牙实现家电的互联互通。

附件清单	
日期	2021年5月13日